PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-270801

(43)Date of publication of application: 09.10.1998

(51)Int.CI.

H01S 3/18 H01L 33/00

(21)Application number: 09-071017

(71)Applicant : SHARP CORP

(22)Date of filing:

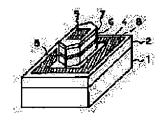
25.03.1997

(72)Inventor: TERAGUCHI NOBUAKI

(54) NITRIDE III-V COMPOUND SEMICONDUCTOR LIGHT EMITTING DEVICE AND ITS MANUFACTURE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve the currentlight output characteristic of a nitride III-V compound semiconductor light emitting device when the laser of the element is oscillated and, at the same time, to reduce the threshold current by forming a nitride III-V compound multilayer semiconductor light emitting device into a hexagonal prism and using the two parallel surfaces of the hexagonal prism as resonator surfaces. SOLUTION: A hexagonal prism-like laser is formed in such a way that, after a conductive GaN single-crystal thin film 2 is grown non a substrate 1 with a buffer layer in between, an SiO2 film 3 is deposited on the thin film 2 and hexagonal windows are lithographically formed through the film 3 by applying a resist to the film 3. Then the SiO2 film 3 is partially etched off to the thin film 2 and the resist is removed. After the resist is removed, a conductive AlGaN clad layer 4 is grown in each window section and an undoped InGa active layer 5, a conductive AIGaN clad layer 6, a conductive GaN



contact layer 7 are successively grown on the clad layer 4 and electrodes 8 and 9 are formed. Since the two parallel resonator surfaces of the hexagonal prism structure have flatness of an atomic order, the occurrence of light losses can be reduced.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

02.12.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

THIS PAGE BLANK (USPTO)

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

THIS PAGE BLANK (USPYO)

(19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出顧公開番号

特開平10-270801

(43)公開日 平成10年(1998)10月9日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号

 \mathbf{F} I

H01S 3/18 H01L 33/00

H01S 3/18 H01L 33/00

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 8 頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特願平9-71017

平成9年(1997)3月25日

(71) 出願人 000005049

シャープ株式会社

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

(72)発明者 寺口 信明

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ

ャープ株式会社内

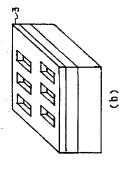
(74)代理人 弁理士 梅田 勝

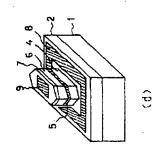
(54) 【発明の名称】 窒化物系III-V族化合物半導体発光素子とその製造方法

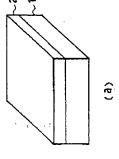
(57)【要約】

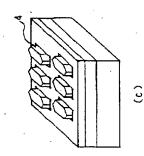
【課題】 窒化物系 I I I - V族化合物半導体装置にお いて、へき開あるいはエッチシグ等を用いないで平坦な 共振器面あるいはストライプ構造を作製することを目的 とする。

【解決手段】 窒化物系111-V族化合物半導体装置 において、基板上に選択成長させて形成された六角柱構 造の平行となる2つの面を共振器面として用いることを 特徴とする。









【特許請求の範囲】

【請求項1】 窒化物系 I I I V族化合物半導体を積層して形成された窒化物系 I I I V族化合物半導体発光素子において、前記窒化物系 I I I V族化合物半導体が六角柱状であり、前記六角柱の平行となる 2 つの平面を共振器面とする窒化物系 I I I V 族化合物半導体発光素子。

【請求項2】 前記共振器面のうち、1 組の対向面積に対して他の2組の対向面積を0.2以下とすることを特徴とする請求項1に記載の窒化物系111-V族化合物半導体発光素子。

【請求項3】 基板上に第1の窒化物系III-V族化合物半導体を成長させる工程と、

前記第1の窒化物系111-V族化合物半導体上に酸化 膜を形成する工程と、

前記第1の窒化物系化合物半導体を露出させるまで、前 記酸化膜を部分的にエッチングして窓を形成する工程 と、

前記窓から六角柱構造の第2の窒化物系111ーV族化 合物半導体を成長させることを特徴とする窒化物系11 I-V族化合物半導体発光素子の製造方法。

【請求項4】 前記窓の形状が六角形であり、平行となる1組の対向長さを1とした場合に、他の2組の対向長さが0.2以下とすることを特徴とする請求項3に記載の窒化物系III-V族化合物半導体発光素子の製造方法。

【請求項5】 前記窓の形状が長方形であり、短辺に対する長辺の長さが22/(7×(3)0.5)以上の比とすることを特徴とする請求項3に記載の窒化物系1 I I - V族化合物半導体発光素子の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、窒化物系 1 1 1 - V族化合物半導体発光素子とその製造方法に関し、特に 六角柱構造を用いた窒化物系 1 1 1 - V族化合物半導体 発光素子とその製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】一般的に、レーザの共振器面の作製には、基板のへき開性を用いた方法が使われている。しかしながら、通常、窒化物系III-V族化合物半導体発光素子に用いられるサファイア基板はへき開性がなく、特開平8-17803号公報に記載されているように、絶縁体であるサファイア基板上に積層した窒化物系III-V族化合物半導体発光素子を下側のコンタクト層までドライエッチングすることで共振器を形成している。【0003】また、スピネル基板($MgAI_2O_4$)を用いて作製した窒化物系化合物半導体発光素子では、"InGaN multi-quantum-Well structure laser diodes grown $MgAI_2O_4$ Substrates"、S.N

akamura et al., Appl. Phys. Lett. 68 (1996) pp2105~2107k 記載されている。図13に従来の111-V族化合物半 導体発光素子の断面図を示す。符号1は基板。2は第1 導電型GaN単結晶薄膜、3はSiOy膜、4は第1導 電型A 10.2 Gao.8 Nクラッド層、5はアンドープの I n_{6.15}Ga_{0.85}N活性層、6は第2導電型A 1_{0.2}Ga a.sNクラッド層、7はp型GaNコンタクト層、8は 第1導電側電極、9は第2導電側電極である。このII 1-V族化合物半導体発光素子では窒化物系 1 I I - V 族化合物半導体のポリッシングによる共振器の形成が行 われている。あるいは"High-quality G aN epitaxiallayer grown b y metalorganic vapor phas e epitaxy on (111) MgAl₂O₄ Substrate", A. kuramata et al., Appl. Phys. Lett. 67 (19 95)pp2521~2523に記載されているように スピネル基板(MgAl2〇4)のへき開性を用いた共振 器の形成が行われている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】へき開性のあるスピネル基板を用いることで共振器面の形成は容易に可能となるが、サファイア基板やスピネル基板は絶縁性であり、基板のへき開性を用いて共振器を形成したとしても下側の電極を形成するために、ドライエッチングによって上側のストライプ電極の側をエッチングする必要がある。しかしながら、エッチングによって形成されたストライプの側面は平坦でなく、レーザ発振における光損失に大きく影響し、レーザ発振のしきい値電流の増大を招く問題が生じた。

【0005】本発明は、上に述べた問題点を解決する共振器端面およびストライプ側面の形成方法を見い出し、レーザ発振の低しきい値電流化を図ることを目的としている。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明の窒化物系III -V族化合物半導体発光素子は、窒化物系III-V族 化合物半導体を積層して形成された窒化物系III-V 族化合物半導体発光素子において、前記窒化物系III -V族化合物半導体が六角柱状であり、前記六角柱の平 行となる2つの平面を共振器面とすることを特徴とす る。

【 0 0 0 7 】前記共振器面のうち、1 組の対向面積に対して他の2組の対向面積を0.2以下とすることを特徴とする。

【0008】また、窒化物系III-V族化合物半導体 発光素子の製造方法は、基板上に第1の窒化物系III - V族化合物半導体を成長させる工程と、前記第1の窒 化物系III-V族化合物半導体上に酸化膜を形成する 工程と、前記第1の變化物系化合物半導体を露出させるまで、前記酸化膜を部分的にエッチングして窓を形成する工程と、前記窓から六角柱構造の第2の窒化物系11-V族化合物半導体を成長させることを特徴とする。【0009】前記窓の形状が六角形であり、平行となる1組の対向長さを1とした場合に、他の2組の対向長さが0.2以下とすることを特徴とする。

【0010】また、前記窓の形状が長方形であり、短辺に対する長辺の長さが22/(7×(3)%%)以上の比とすることを特徴とする。

[0011]

【発明の実施の形態】

(実施の形態1)図1に、六角柱形状レーザを作製する場合の製造工程断面図を示す。基板1上に、図示しないが低温成長GaNバッファ層を介して、第1導電型のGaN単結晶薄膜2をMOCVD法によって成長する。この時の製造工程の斜視図を図1(a)に示す。

【0012】次に、第1導電型のGaN単結晶薄膜2の上にCVD法により SiO_2 膜3を堆積し、その上にレジストを塗付し、フォトリソグラフィーによって六角形状の窓を形成する。次に、レジストをマスクとしてドライエッチングにより部分的に SiO_2 膜3を第1導電型のGaN単結晶薄膜2まで除去し、さらにレジストを除去する。この時の製造工程の斜視図を図1(b)に示す。

【0013】次に、基板1を再びMOCVD装置内に導入し、 SiO_2 膜3をマスクにして選択成長を行い、窓部分に順次、第1導電型AlGaNクラッド層4を成長させる。

【0014】さらに、連続してアンドープInGaN活性層5、第2導電型A1GaNクラッド層6、第2導電型GaNコンタクト層7を成長させる。最後に、 SiO_2 膜3を除去し、フォトリソグラフィーを用いて第1導電側電極8、第2導電側電極9を形成し、チップ分割することでレーザが作製できる。この時の製造工程の斜視図を図1(d)に示す。

【0015】窒化物系III-V族化合物半導体の結晶成長条件を選ぶことによって窓部分にのみ結晶成長することが可能となる。この場合、MOCVD法がより優位な結晶成長法であった。

【0016】また、窓部分に成長させる六角柱は、成長の初期段階より1つの結晶核からその結晶を徐々に大きくしていくことがより好ましい。しかしながら、成長の初期段階で複数の六角柱が発生した場合でも、結晶成長速度を最適化することによってそれぞれの六角柱が結合し、1つの六角柱にすることができる。六角柱の面内方向の成長は、窓のパターンに達すると停止し、その後は面に垂直な方向にのみ成長が進行する。

【0017】本実施の形態では、異なる3つの六角形状の窓から選択成長させた窒化物系III-V族化合物半

導体発光素子を作製した。この時の窓の形状を図2に示す。図2(a)に示す窓の形状は正六角形であり、1辺 aを30μmとした。

【0018】図2(b)に示す窓のバターン形状は、平行となる1組の対向長さを1とした場合に、他の2組の対向長さを0.2とした形状である六角形であり、短辺になる 0μ m、長辺を 65μ mとした。ここで、対向長さとは平行な辺に重線を引いてできる最大の長方形での問題の長さのことである。

【0019】また、図2(c)に示す窓のバターン形状は平行となる1組の対向長さを1とした場合に、他の2組の対向長さを0とした形状であり、短辺aを 30μ m、長辺を 90μ mとした。

【0021】本発明の窒化物系III-V族化合物半導体発光素子での図2(c)に示す窓から成長させた構造での発振スペクトルを図3に示す。図3に示すように、レーザの発振スペクトルはほぼ単一のピークとなっており、従来の電極ストライプ構造のレーザより発振波長の単一性が向上している。これは、本発明のように六角柱構造を用いた場合、レーザの共振器長が六角柱構造の大きさのみによって決定され、六角柱構造の大きさを変えることで、極めて容易に単一波長の発振レーザが実現できるためである。

【0022】一方、従来のへき開して共振器端面を形成する場合には、素子作製の歩留り等の問題から数百μm以上に制限されるため、単一波長発振は困難である。なお、六角柱の大きさが小さすぎた場合、上部電極の形成が困難となるため、共振器長としては10μm以上の長さが好ましい。

【0023】また、異なる六角形状の窓から成長させて作製した窒化物系III-V族化合物半導体発光素子の注入される電流密度と光出力との関係を図4に示す。本実施の形態と同一の層構造でポリッシングおよびドライエッチングを用いて作製した従来のレーザに比べ、図2(b)、(c)に示す窓から成長させた構造ではしきい値電流密度が低減できた。これは、本発明の六角柱構造の平行となる2つの面を共振器面として用いた場合、六角柱構造の表面が原子オーダーで平坦な面となっているため、ポリッシングなどで形成した共振器面あるいはドライエッチングで形成したリッジ側面に比べて平坦性が

著しく改善され、その結果、共振器面およびリッジ側面での光の損失が著しく低減されるためである。一方、図2(a)の場合には、共振器面が3方向で形成されるため、光の閉じ込め効率が悪く、発振までに至らなかった。

【0024】また、図4に示されるように1辺の対向面 積が他の辺の対向面積より大きくなるにつれて、しきい 値電流密度は減少している。これは、六角柱構造が正六 角形の場合、レーザ発振が3つの共振器面方向で起こる ため、しきい値電流密度の増大を招くためである。この 状態での発振の模式図を図5(a)に示す。しきい値電 流密度を低減するには、六角柱の1組の平行な面の対向 面積を他の2組の面の対向面積よりも大きくすることが 必要である。1組の長辺の長さをおとし、他の最も長い 辺をaとすると、b≧15a/7を満たす六角形状の窓 から成長させた窒化物系「II-V族化合物半導体発光 素子での発振の模式図を図5(b)に示す。窓の形状は 平行となる1組の対向長さを1とした場合に、他の2組 の対向長さをを0.2とした形状である六角形であり、 ほぼ一方向からレーザ発振が生じ、わずかに他の2方向 からレーザ発振が生じていることが示されている。

【0025】また、 $b \ge 3$ a を満たす六角形の窓から作製した場合には、1 方向にのみ共振器が形成され、他の2方向には共振器は形成されずに理想的なレーザ構造となる。この場合の発振の模式図を図5(c)に示す。

【0026】平行となる1組の長辺の面の対向長さをbであり、他の2組の平行な面の対向長さをcとすると、窓のパターン形状の六角形でのc/bを横軸にとり、c/bの時のしきい値電流密度とc/b=0の時のしきい値電流密度との比を縦軸にとり、その相関関係を示す図を図6に示す。実用的にはc/b=0の時のしきい値電流密度の2倍までが好ましい。

【0027】一方向にのみ共振器が形成されていること、つまり窓のパターン形状の六角形がでどり=0である場合、つまりり≥3aである場合が理想的であるが、図6に示すように、実用的には1つの組みの対向長さに対する他の2つの組の対向長さが0.2以下することによって、従来構造のレーザよりもしきい値電流を大幅に低減することが可能であり、実用的と考えられる。この場合、窓のパターン形状の六角形がり/a=15/7以下であるという条件を満たしていればよい。

【0028】(実施の形態2)実施の形態1では、形成するレーザの六角柱構造と同一形状の窓を設けることによって六角柱構造を得ることが可能となるが、本実施の形態ではより簡便な窓の形状としては長方形として、本実施の形態では、異なる3つの長方形状の窓を有する酸化膜を選択成長のマスクとして用いた。図7は長方形の形状の窓からなる層から成長させた六角柱構造の半導体レーザの上面図である。

【0029】長方形の窓の短辺の長さを50μmとし

て、図7(a)に示す窓は長辺と短辺の比を1.15とした長方形(長辺の長さ57.5 μ m)であり、図7(b)に示す窓は、長辺と短辺の比が2.0(比が22 μ (7、(3) μ 0)以上4 (3) μ 0以下)とした長方形(長辺の長さ100 μ m)、図7(c)に示す窓は長辺と短辺の比が2.5(比が4 (3) μ 0以上)とした長方形(長辺の長さ125 μ m)である。窓の長方形状内に窒化物系III-V族化合物半導体発光素子を実施の形態1と同様の製造工程を用いて作製した。

【0030】六角柱構造を正六角形状のレーザを図7 (a)に示し、平行となる1組の対向長さを1とした場合に、他の2組の対向長さが0、2以下となる六角形柱のレーザを図7 (b)に示し、平行となる1組の対向長さを1とした場合に、他の2組の対向長さが0となる六角形柱を図7 (c)に示す。

【0031】図8に、異なる長方形状の窓から成長させたレーザの電流一光出力特性を示す。なお、レーザの層構造は、実施の形態1と同様である。駆動電流は、パルス幅1μsec,パルス周期1msecのパルス電流である。図8から明らかなように、長方形状の長辺が短辺に対して大きくなるに従って、しきい値電流密度は減少している。図7(a)に示す正六角形の構造では、発振まで至らなかった。

【0032】図7(c)に示すような理想的な六角柱構造を得るためには長方形の長辺と短辺との比を4/ (3)^{0.5}以上にすることが必要である。

【0033】一方向にのみ共振器が形成されているのが理想的であるが、実際のレーザでは、1つの組の対向面積を1とした場合に、他の2組の対向面積を0.2以下程度にしても、実施の形態1で記載したように、従来構造のレーザよりもしきい値電流を大幅に低減することが可能であり、この場合には長方形の長辺と短辺との比を22/(7×(3)^{0.5})以上にすれば良い。

【0034】(実施の形態3)六角形あるいは長方形の 窓のパターン形状での平行な1組の辺と六方晶である窒 化物系111-V族化合物半導体の等価な6つのa軸の うちの1つと垂直になっていることが望ましい。窒化物 系化合物半導体の結晶面とa軸との関係を図9に示す。 図9に示されるように、六角柱構造の壁面がa軸と直交 する面であることに起因する。実際の結晶成長の場合に は、もう少し条件をゆるめることができ、90°±5° の角度範囲内にあればよい。

【0035】基板としてSiCを用いた場合、SiC基板のa軸に対して長方形の長辺が90°の角をなす方向に形成された窓の形状を図10(a)に示す。次に、窒化物系III-V族化合物半導体のa軸に対し長方形の長辺が45°の角をなす方向に形成された窓の形状を図10(b)に示す。更に、窒化物系111-V族化合物半導体のa軸に対し長方形の長辺が60°の角をなす方向に形成された窓の形状を図10(c)にしめず、図1

0 (a) ~ (c) に示す窓の形状内に覧化物系1 I I ~ V族化合物半導体を成長させた六角柱構造も図中に示している。長方形の形状は、長辺と短辺の比が2.5とした長方形(長辺の長さ125μm)であり、同一のものとした。この図により、図10(a)に示すSiC基板上のa軸に対し長方形の長辺が90°の角をなす方向に形成された窓のパターン形状の時、最も望ましい六角柱構造の窒化物系 I I I ~ V族化合物半導体が形成されていることがわかる。

【0036】一般に、化合物半導体の結晶成長方向は、基板1の結晶構造、面方位によって決定される。基板1として6H-SiCのようなウルツ鉱構造を有する材料の(001)面(c面)を用いた場合、基板のa軸と窒化物系1-1-V族化合物半導体であるGaNのa軸は完全に一致し、長方形の長辺をこれと直交するように窓を形成すればよい。基板としてサファイアを用いた場合には、サファイアのa軸に対してGaNのa軸が30°回転した方向にGaNが成長するため、長方形の長辺をサファイア基板の30°回転するように窓を形成すればよい。

【0037】図11に実施の形態1と同様の製造工程を 用いて作製したレーザの電流-光出力特性を示す。な お、レーザの層構造は、実施の形態1と同様である。駆 動電流は、パルス幅1μsec、パルス周期1msec のパルスである。

【0038】図11から明らかなように、図10(a)に示す窒化物系III-V族化合物半導体発光素子の共振器面が形成されレーザ発振しているが、図10(b)、(c)に示す窒化物系III-V族化合物半導体では発振の効率が非常に悪かった。また、図10(b)、(c)の場合には、得られる窒化物系III-V族化合物半導体の形状が一定していなかった。したがって、六角形あるいは長方形の平行な1組の辺が六方晶をとる窒化物系III-V族化合物半導体の等価な3つのa軸のうちの1つと垂直になっていることが望ました。

【0039】なお、実施の形態では、図12(a)に示す直交する2本の2回対称軸を有する六角柱構造について述べているが、図12(b)に示すような1本の2回対称軸を有する六角柱構造や、対称軸を有しない図12(c)に示すような六角柱構造でもレーザ発振可能であるが、共振器面のうちの1つの組の対向面積を1とした場合に、他の2組の対向面積が0.2以下となっていることが好ましい。

【0040】本発明は、六方晶をとる窒化物系111-

V族化合物半導体であれば、GaN、InGaN、A1 GaN以外にも適用でき、例えばBNでもよい。

[0041]

【発明の効果】本発明において見い出したレーザ構造を 用いることにより、共振器やレーザ素子の作製が容易に なり、また、窒化物系 I I I V族化合物半導体素子特 性が向上し、さらに容易に単一波長発振レーザが実現で きる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る六角柱構造のレーザ素子の製造工程を示す斜視図である。

【図2】本発明に係る窓の形状を示す図である。

【図3】実施の形態1のレーザの発振スペクトルを示す。 図である。

【図4】実施の形態1のレーザの電流-光出力特性を示す図である。

【図5】実施の形態1に示す六角柱構造のレーザの共振 器面の関係を示す図である。

【図6】c/bと、c/b=0の時のしきい値電流密度 に対するしきい値電流密度の比との相関を示す図であ る。

【図7】実施の形態2の長方形の窓から成長させた六角 柱構造のレーザの上面図である。

【図8】実施の形態2のレーザの電流-光出力特性を示す図である。

【図9】窒化物系化合物半導体結晶のa軸と結晶面の関係を示す図である。

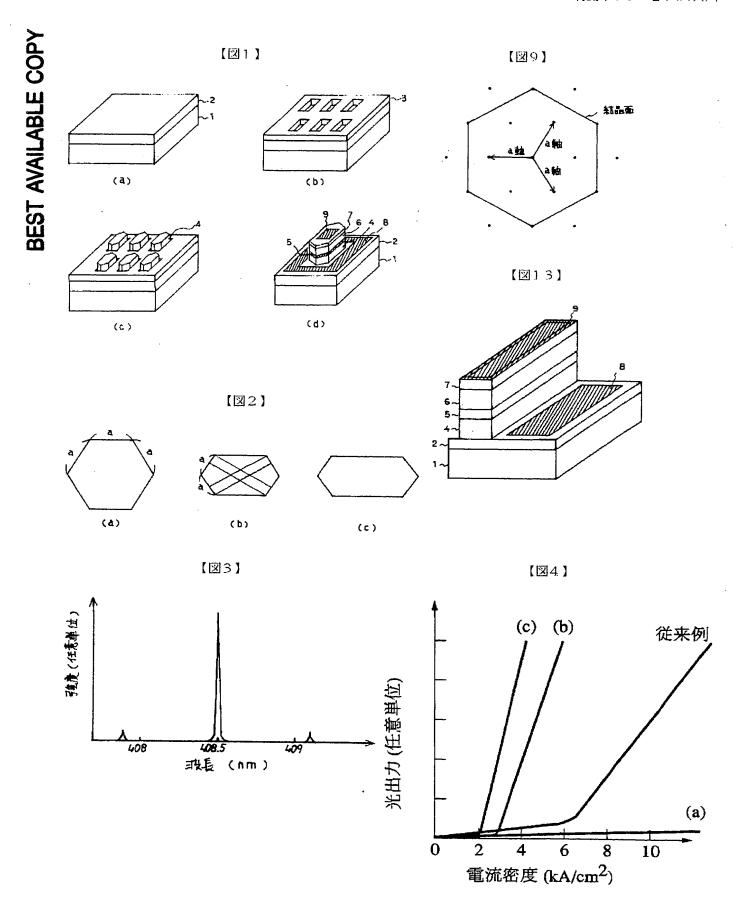
【図10】実施の形態3の長方形の窓から成長させた六 角柱構造のレーザの上面図である。

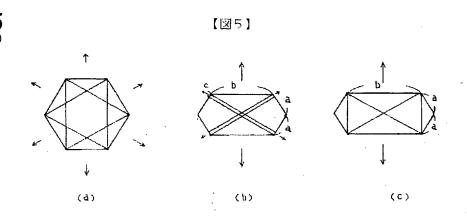
【図11】実施の形態3のレーザの電流-光出力特性を示す図である。

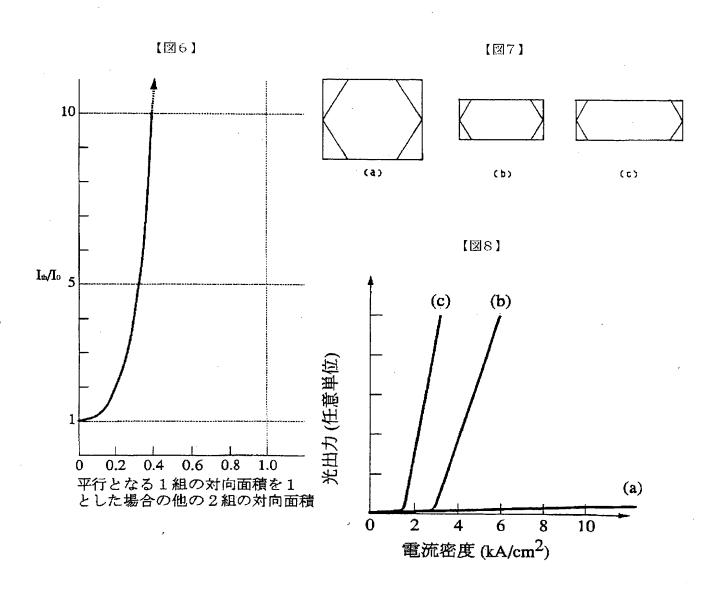
【図12】さまざまな六角柱構造のレーザを示す図である。

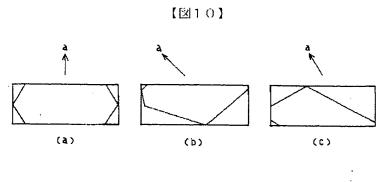
【図13】従来構造のレーザを示す図である。 【符号の説明】

- 1 基板
- 2 第1導電型GaN単結晶薄膜
- 3 SiO₉膜
- 4 第1導電型A1GaNクラッド層
- 5 アンドープInGaN活性層
- 6 第2導電型A1GaNクラッド層
- 7 第2導電型GaNコンタクト層
- 8 第1導電側電極
- 9 第2導電側電極

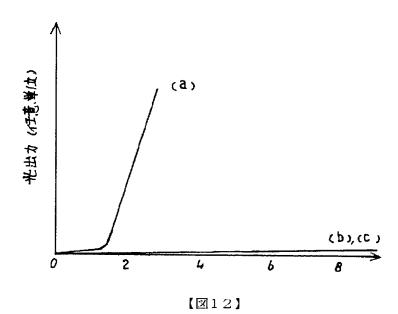








【図11】



(a) (b) (c)